

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 6 月 6 日(06.06.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/080708 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) C09J 11/04 (2006.01)
C08K 9/06 (2006.01) C09J 163/00 (2006.01)
C09J 7/00 (2006.01) H01L 21/60 (2006.01)
C09J 9/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/077430
- (22) 国際出願日: 2012 年 10 月 24 日(24.10.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-259868 2011 年 11 月 29 日(29.11.2011) JP
- (71) 出願人: 東レ株式会社(TORAY INDUSTRIES, INC.)
[JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 榛葉陽一(SHIMBA, Yoichi); 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 藤丸浩一(FUJIMARU, Koichi); 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 野中敏央(NONAKA, Toshihisa); 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: RESIN COMPOSITION, RESIN COMPOSITION SHEET, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、樹脂組成物シート、半導体装置およびその製造方法

(57) Abstract: Provided is a resin composition which has both a high storage stability and a high interface reliability, said resin composition comprising: (a) an epoxy compound; (b) a microcapsule type hardening accelerator; and (c) inorganic particles surface-modified with a compound having an unsaturated double bond.

(57) 要約: (a) エポキシ化合物、(b) マイクロカプセル型硬化促進剤ならびに(c) 表面が不飽和二重結合を有する化合物で修飾されている無機粒子を含有する樹脂組成物により、保存安定性と接続信頼性の両方の特性に優れた樹脂組成物を提供する。



WO 2013/080708 A1